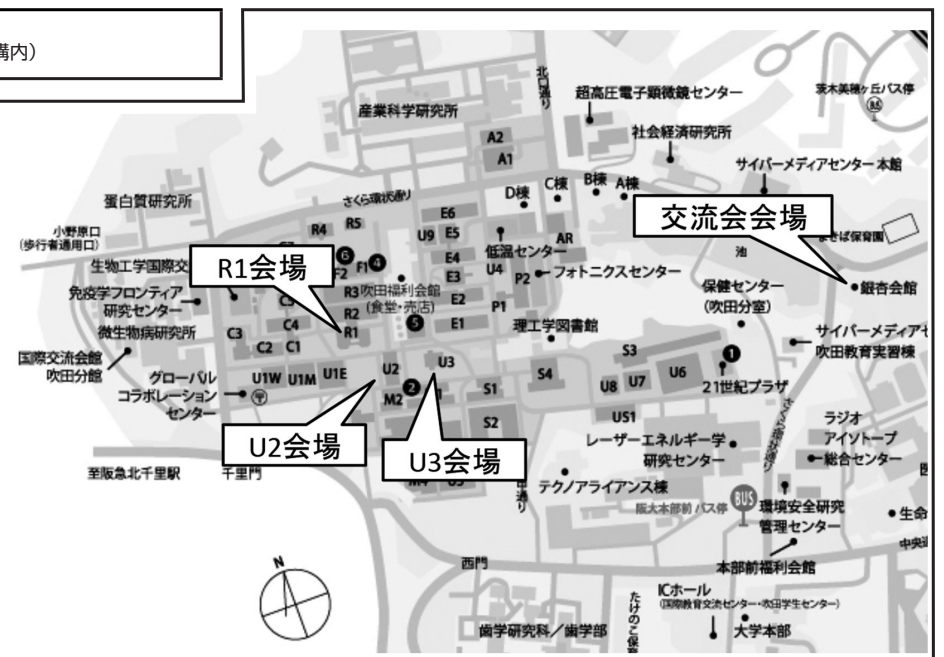


MES 2015 プログラム			9月3日(木)	
	A会場	B会場	C会場	D会場
9:50	[1A1] パワエレ-1 1. パワー半導体パッケージ技術の最新動向 ○高橋良和, 西村孝孝, 池田良成 (富士電機) (依頼講演 40分) 2. Niめっき/Sn-0.7Cuはんだ接合界面の高耐久熱化技術 ○門口卓矢 ¹ , 武直矢 ¹ , 山中公博 ² , 長尾至誠 ³ , 菅沼克昭 ³ (¹ トヨタ自動車, ² 中京大学工学部, ³ 大阪大学産業科学研究所) 3. WBG半導体パワーデバイス用Cu/Alクラッドリボン配線の高信頼性 ○林世瑛, 長尾至成, 菅原徹, 横井絵美, 菅沼克昭 (大阪大学 産業科学研究所) 4. ラマン分光法を用いたSiCパッケージの応力の定量評価 ○内田智之, 小坂賢一, 杉江隆一, 遠藤亮 (東レリサーチセンター)	[1B1] めっき技術-1 1. 電気化学的手法を用いた銅-モリブデン合金薄膜の作製と評価 ○小岩一郎 ¹ , 川村 渉 ² , 渡辺宜朗 ¹ (¹ 関東学院大学理工学部, ² 関東学院大学大学院工学研究科) 2. TSV高速めっき充填技術 ○ガマハ ¹ , 近藤和夫 (大阪府立大学) 3. 硫酸銅めっき液中における一価銅の生成に及ぼす塩素ならびPEGの効果 ○古賀淑哲, 野間弘昭, 野中一洋, 坂田義太郎, 寺崎 正 (産業技術総合研究所) 4. シリコンウェーハ上への直接無電解めっき ○八重真治 ¹ , 山田直輝 ¹ , 阪本 進 ² , 福室直樹 ¹ (¹ 兵庫県立大学, ² 日本イコス)	[1C1] ものづくりセッション-1 (10:30~) 1. 無電解めっき技術によるUBMの形成 ~ エピタキソプロセスの紹介 ○柴田利明, 小田幸典, 橋本滋雄 (上村工業) 2. 密着性、平滑性に優れた銅素材への黒色化処理 ○酒井博章, 姜 俊行, 喜多あずさ (奥野製薬工業) 3. ビットレスハーフエッチプロセスHE3-530 ○畑中亮英, 文蔵隆志, 安藤裕久, 沈 曉鷹 (JCU)	[1D1] 信頼性評価・解析-1 1. 半導体実装におけるAgワイヤの信頼性研究 ○Xing Wei, Zhou Yu, Xi Zhang, Wanneng Xu, Tomonori Iizuka, Kohei Tatsumi (早稲田大学大学院情報生産システム研究科) 2. 恒温恒湿環境下での導電性接着剤の長期信頼性に与える銀フィラー形状の影響 ○田島 潤 ¹ , 西川 宏 ² (¹ 大阪大学大学院工学研究科, ² 接合科学研究所) 3. 動的粘弾性測定を用いた両面粘着テープの繰り返しクリープ評価 ○古山昌治, 水谷大輔, 谷 元昭 (富士通研究所) 4. 静電容量型検査システムに関する研究 ○野口祐智 (電機大)
11:30				
12:20	[1A2] 新規接合材料 1. ニッケルナノ粒子を用いた接合材料の開発 ○清水隆之 ¹ , 千葉将之 ¹ , 北村直也 ¹ , 安藤秀樹 ¹ , 松原典恵 ² , 宇野智裕 ² (¹ 新日鉄住金化学, ² 新日鐵住金) 2. 金属表面処理と樹脂-金属界面の接合強度および熱特性 ○松嶋道也, 加藤裕太, 武知佑輔, 福本信次, 藤本公三 (大阪大学) 3. フィラー含有ハイブリッド樹脂実装における実装性と樹脂特性の評価 ○数田康平, 山内浩平, 福本信次, 松嶋道也, 藤本公三 (大阪大学大学院) 4. 熱硬化性バインダを用いた導電性接着剤の導電パス形成のカイネティクス ○飯田将基, 坂庭慶昭, 多田泰徳, 井上雅博 (群馬大学) 5. パワーデバイス用高信頼性封止樹脂の開発 ○立岡正明, 鈴木琴美, 仲俣祐子, 市村裕司, 高橋良和 (富士電機)	[1B2] めっき技術-2 1. 平滑基材面への無電解めっき技術 ○赤井邦彦, 江尻芳則, 山村泰三, 中川昌之 (日立化成) 2. 無電解銅めっき触媒用銀ナノ粒子の開発 ○新林昭太 ¹ , 深澤憲正 ¹ , 関根信博 ¹ , 佐野義之 ¹ , 白髪 潤 ¹ , 本間秀和 ² , 森口朋 ² , 清水 優 ² , 姜 俊行 ² (¹ DIC, ² 奥野製薬工業) 3. 感光性フィルムへの選択的無電解パターンめっき技術の開発 ○平尾昂平, 海老原雅彦, 榎本哲也, 村上泰治 (日立化成) 4. 無電解Ni/Pd/Auめっきにおけるはんだボール接続信頼性—無電解Pdめっき膜厚の影響— ○江尻芳則 ¹ , 納堂高明 ¹ , 高橋昭男 ¹ , 櫻井健久 ¹ , 荒山貴慎 ² , 坪松良明 ² , 長谷川清 ¹ (¹ 日立化成, ² 日立化成テクノサービズ) 5. 無電解Pd/Auめっき厚さがはんだボール高速シア強度に及ぼす影響 ○亀井 勝 (JX 金属商事)	[1C2] ものづくりセッション-2 1. 高機能接着フィルム ADFLEMA ○日馬宗俊, 寺木 慎, 近藤寿夫 (ナミックス) 2. PETフィルムへの半田実装の提案 ○田嶋久容, 奥園博和 (東レエンジニアリング) 3. 電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤 ○徳平英士 (富士通クオリティ・ラボ) 4. プラズマインジケータを用いたプラズマ診断法 ○大城盛作, 菱川敬太, 山川 裕, 宮崎裕司, 采山和弘, 中村慶子 (サクラレクス) 5. 各種センサデバイスのウェアラブル・ヘルスケア応用 ○丹羽大介 (ローム)	[1D2] 信頼性評価・解析-2 1. 次世代パワーデバイスの評価解析 ○今井康雄, 久保田英久, 中村典子, 立山博丈, 大谷直己, 前角知生, 長谷川寛 (沖電気エンジニアリング) 2. AE法を用いたシリコンチップの強度評価 ○金野雄志 ¹ , 菊地 広 ¹ , 田代 忍 ¹ , 土井良介 ¹ , 石塚典男 ² , 緒方公俊 ² (¹ 日立オートモティブシステムズ, ² 日立製作所) 3. 銅ダマシ法により作製した半導体デバイス用配線材料の交流インピーダンス法による信頼性解析(第2報) ○柴沼亮佑, 吉原佐知雄 (宇都宮大学院工) 4. 実装基板の信頼性に関する解析手法の開発 ○今井康雄, 佐藤晃太郎, 大谷直己, 村原大介, 岡 克己, 中嶋龍一, 味岡恒夫 (沖電気エンジニアリング) 5. フリップチップパッケージ用アンダーフィル材の物性最適化 ○鈴木直也, 小野関仁, 高橋寿登, 出口央視 (日立化成)
14:00	ものづくりコアタイム			
14:00	U3 棟 211			
15:00	MES2014 表彰式			
15:20	招待講演			
16:20	1. 体内時計と健康 大石勝隆氏 (産業技術総合研究所)			
16:20	招待講演			
17:20	2. 太陽光発電の進展と現在の研究開発動向 松村道雄氏 (大阪大学 名誉教授)			

A会場: U2 棟 311
 B会場: U2 棟 312
 C会場: U2 棟 213
 D会場: R1 棟 岡田メモリアルホール
 ものづくり展示コーナー: U2 棟 212
 受付: U2 棟 2階

17:50 交流会
 会場: レストランミネルバ (大阪大学構内)
 19:50



MES 2015 プログラム		9月4日(金)		
	A会場	B会場	C会場	
9:00	<p>[2A1] パワエレ-2</p> <p>1. 高強度はんだ材料の車載用直接冷却パワーモジュールへの適用 ○玉井雄大, 西村芳孝, 望月英司, 高橋良和(富士電機)</p> <p>2. 車載用パワーモジュールのパッケージ技術 ○加藤遼一, 郷原広道, 稲葉祐樹, 百瀬文彦, 西村芳孝, 望月英司, 高橋良和(富士電機)</p> <p>3. 電子機器冷却におけるCFDを用いた逆解析から得られる感度情報の有効活用 ○大串哲朗, 村上政明, 高野公敏, 池島 薫, 桃瀬一成(アドバンスドナレッジ研究所)</p> <p>4. LED ランプの軽量化のための放熱設計手法 ○井岡久美子, 井上道信(東芝)</p>	<p>[2B1] プリントエレクトロニクス-1</p> <p>1. プリントエレクトロニクスのための高精度印刷 ○牛島洋史, 日下靖之, 野村健一, 藤田真理子, 後藤理恵, 山本典孝, 安部浩司(産業技術総合研究所フレキシブルエレクトロニクス研究センター) (依頼講演 40分)</p> <p>2. ナノインクを用いた印刷形成した銀電極を有するInGaN/GaN青色発光ダイオードの電気特性と発光特性 ○小泉 淳¹, 重宗 翼¹, 柏木行康², 垣内宏之³, 山本真理², 斉藤大志², 松川公洋², 高橋雅也², 大野敏信², 中野昌美², 青柳伸宜³, 吉田幸雄³, 児島貴徳¹, 藤原康文¹(¹大阪大学大学院工学研究科, ²大阪市立工業研究所, ³大研化学工業)</p> <p>3. プリントプロセスの実装を志向したフィルム型接続技術の柔軟性について ○三井亮介, 佐藤卓也, 高橋誠哉, 中島伸一郎(日本航空電子工業)</p>	<p>[2C1] 信頼性評価・解析-3</p> <p>1. 超音波洗浄時のシミュレーションと可視化による現象解析 ○岡 賢吾, 今田真嗣, 山田博之, 春日井浩, 伊藤修一(デンソー)</p> <p>2. フリップチップ接合されたSiチップのラマン分光法による残留応力の評価 ○伊藤元剛, 鈴木直紀, 杉江隆一(東レリサーチセンター)</p> <p>3. 放熱性とはんだ接続信頼性に優れた実装基板コーティング材の開発 ○伊藤真紀, 石井利昭(日立製作所)</p> <p>4. セラミック基板の低温バイアス化での絶縁低下のメカニズム ○浅井康富, 中村俊浩, 沼崎浩二(デンソー)</p>	<p>[2D1] 先端インターコネクト</p> <p>1. 薄いAu薄膜を用いたFeバルク材の室温接合と接合性能 ○魚本 幸, 島津武仁(東北大学)</p> <p>2. FC実装における一括接合技術の開発 ○小野関一, 高橋 宏, 鈴木直也, 山田薫平(日立化成)</p> <p>3. マイクロポンプ自己形成における不活性雰囲気リフロープロセスによるボイド低減効果 ○石田三都輝, 安田清和(大阪大学)</p> <p>4. Au先鋭パンプの超音波常温接合挙動 ○岩綱圭一郎, 中堂尚賢¹, 千田洋輔, 浅野種正(九州大学 システム情報科学府)</p>
10:20				
10:30	<p>[2A2] パワエレ-3</p> <p>1. シンタ材における機械的特性のばらつきに及ぼす焼結条件の影響 ○奥野翔太¹, 于 強¹, 中田裕輔²(¹横浜国立大学工学部, ²カルソニックカンセイ)</p> <p>2. 三点曲げ試験と有限要素解析による焼結金属接合材の機械的特性評価 ○鈴木智久¹, 保田雄亮¹, 川名祐貴², 石川 大², 西村正人², 中子偉夫², 蔵淵和彦², 守田俊章¹, 寺崎 健¹(¹日立製作所, ²日立化成)</p> <p>3. Auナノポーラスシートを用いた接合体の高信頼性 ○松永香織¹, Min-Su Kim¹, 西川 宏², 齋藤美紀子³, 水野 潤³(¹大阪大学大学院工学研究科, ²大阪大学接合科学研究所, ³早稲田大学ナノ理工学工学機構)</p> <p>4. 表面活性化接合法に基づいたSiC-SiCとSiC-Siウェハ接合 ○母 風文¹, 藤野真久¹, 須賀唯知¹, 井口研一², 中澤治雄², 高橋良和²(¹東京大学工学研究科, ²富士電機)</p> <p>5. ナノスプリング層を用いた高信頼実装構造 ○谷江尚史¹, 澄川貴志², 北村隆行²(¹日立製作所, ²京都大学)</p>	<p>[2B2] プリントエレクトロニクス-2</p> <p>1. 微細印刷技術の進展とフレキシブルデバイス応用 ○時任静士(山形大学) (依頼講演 40分)</p> <p>2. ソフトブランケットを用いた3次元曲面への微細配線印刷技術 ○泉 小波, 時任静士(山形大学 有機エレクトロニクス研究センター)</p> <p>3. グラビアオフセット印刷用銀ナノ粒子インクの開発 ○塩川大介, 落合祐夫, 泉 小波, 熊木大介, 時任静士(山形大学 有機エレクトロニクス研究センター)</p> <p>4. 垂直多関節ロボットを用いた全方向インクジェット印刷技術の開発 ○吉田泰則, 泉 小波, 時任静士(山形大学 有機エレクトロニクス研究センター)</p>	<p>[2C2] 材料・プロセス</p> <p>1. 超高密度配線対応 次世代向け層間絶縁材の検証 ○出口英寛, 田中照久, 笠間裕二, 白波瀬和孝(積水化学工業)</p> <p>2. 自己折出型コーティングの銅素材への適用 ○豊島幹人, 南 淳一, 石井 均(日本バーカライジング)</p> <p>3. 電気化学的手法を用いた硫化物半導体粒子の作製 ○岡本尚樹, 片岡健太郎, 神林 洗, 齊藤丈靖, 近藤和夫(大阪府立大学)</p> <p>4. 電気化学的手法によるSn系Liイオン二次電池用負極材の作製 ○岡本尚樹, 藤山貴友, 中井那美, 岡田孝史, 齊藤丈靖, 近藤和夫(大阪府立大学)</p>	<p>[2D2] 3次元ICパッケージ-1</p> <p>1. 2.1D有機インターポザの実装技術開発 ○渡邊真司, 岩崎俊寛, 玉川道昭, 宮腰 武, 出町 浩, 佐藤秀夫, 池元義彦(ジェイデバイス)</p> <p>2. Sn-Ag系薄膜接合による3D-IC実装プロセスに関する研究 ○岩田剛治, 重本拓巳, 米田聖人, 山本宗裕, 佐藤了平(大阪大学)</p> <p>3. 高精度ウエハ接合プロセスの解析支援・最適化 ○三ツ石創, 菅谷 功, 津藤高志, 中平法生, 大森 薫, 福田 稔, 岡本和也(ニコン)</p> <p>4. 大面積チップサイズ対応のTSVチップ積層技術の開発 ○吉良秀彦¹, 増山卓己², 海沼則夫², 中村公保², 飯島早苗²(¹富士通, ²富士通アドバンスドテクノロジー)</p> <p>5. 複合表面活性化接合(SAB)による3D集積化のための低温ウエハ接合 ○Ran He¹, Masahisa Fujino¹, Akira Yamauchi², Tadatomo Suga¹(¹The University of Tokyo, ²Bondtech)</p>
12:10				
13:00	<p>[2A3] プリントエレクトロニクス-3</p> <p>1. 大気焼成可能な低温焼結性銅材料の開発 ○井田清信, 友成雅則, 渡辺 満, 磯部 薫(石原産業)</p> <p>2. 銅ナノ粒子含有ポリシルセスキオキサン溶液による無電解銅めっきパターンの形成 ○後藤聖弥¹, 村橋浩一郎¹, 大塚邦顕¹, 御田村絃志², 渡瀬星晃², 松川公洋²(¹奥野製業工業, ²大阪市立工業研究所)</p> <p>3. ダイアタッチ剤: ワイドバンドギャップ半導体用新規溶剤を用いた銀ペースト ○鈴木陽二¹, 坂西裕一², 赤井泰之², 酒金婷¹, 菅沼克昭¹(¹ダイセル, ²大阪大学)</p> <p>4. 紙基板の誘電率制御によるフレキシブルアンテナの小型化 ○乾 哲治, 古賀大尚, 能木雅也, 菅沼克昭(大阪大学)</p> <p>5. プラズマ焼結法による銅配線の作製 ○小泉 剛¹, 高 悦², 酒 金婷², 長尾至成², 菅沼克昭²(¹電子技研, ²大阪大学産業科学研究所)</p>	<p>[2B3] JEITA・実装技術ロードマップ 2015 報告会 -1</p> <p>1. はじめに(ロードマップの歴史と概要紹介)</p> <p>2. 注目される市場と電子機器群</p> <p>3. 小型、低コスト、高速化を支える半導体パッケージ</p> <p>4. 変化する将来の生活環境と世界をリードする電子部品</p>	<p>[2C3] MEMS</p> <p>1. マイクロ流体技術を用いた液体有機発光デバイスの開発とその応用 ○水野 潤¹, 笠原崇史¹, 津脇美帆¹, 松波成行², 江面知彦², 石松亮一², 大島寿郎³, 今任稔彦², 庄子習一¹, 安達千波矢²(¹早稲田大学, ²九州大学, ³日産化学工業) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 生体信号測定用スマートシャツに用いるドライ電極の特性評価 ○天野祐作, 多田泰徳, 板橋洋介, 井上雅博, 佐藤友信, 齋藤 繁(群馬大学)</p> <p>3. インプリント圧力より高い飽和蒸気圧の凝縮性ガスを用いたUVナノインプリントプロセス ○鈴木健太, 尹 成圓, 高木秀樹, 廣島洋(産業技術総合研究所)</p> <p>4. 放射光励起液相反応による金属ナノ粒子生成と応用 ○村上元規¹, 山口明啓¹, 岡田育夫², 福岡隆夫¹, 内海裕一¹(¹兵庫県立大学, ²名古屋大学)</p>	<p>[2D3] 3次元ICパッケージ-2</p> <p>1. 高耐熱仮貼り材料の開発 ○藤原健典, 有本真治, 小田拓郎, 富川真佐夫(東レ)</p> <p>2. SiO₂上への無電解CoWPめっき膜の形成と膜質の評価 ○平手惇史, 宮地悠人, 太田晃平, 清水智弘, 新宮原正三(関西大学)</p> <p>3. SiO₂上への無電解NiWPめっき膜の形成と膜質の評価 ○宮地悠人, 平手惇史, 太田晃平, 清水智弘, 新宮原正三(関西大学)</p> <p>4. 3D-IC用層間材料におけるマトリクスの検討 ○杉山雅哉, 山本英広, 竹下 寛, 池本 慎, 桐谷秀紀, 河瀬康弘(三菱化学)</p> <p>5. Si/Cu同時研削と残留金属低減処理を用いたTSV露出工程のCu汚染評価 ○渡辺直也¹, 青柳昌宏¹, 片川大輔², 坂東 翼³, 三井貴彦³, 山本栄一³(¹産業技術総合研究所, ²アプライアテクノロジー, ³岡本工作機械製作所)</p>
14:40				
15:10	<p>[2A4] パワエレ-4</p> <p>1. 極限環境パワー半導体の異相界面制御 ○菅沼克昭, 長尾至成, 菅原 徹, 酒 金婷, 横井絵美(大阪大学 産業科学研究所) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 高熱伝導ペーストの開発と応用 ○齊藤 寛, 後藤英之, 相原正巳, 上田雅行, 村岡 悠, 中城治之(ハリマ化成)</p> <p>3. Agナノ粒子焼結体の低サイクル疲労き裂発生および進展挙動 ○塩田竜太郎¹, 刈谷義治², 水村宜司³, 佐々木幸司³(¹芝浦工業大学大学院, ²芝浦工業大学工学部, ³ナミック)</p> <p>4. Ag膜上に成膜したCu₂Oの解析 ○佐藤敏一, 石崎敏孝, 明渡邦夫(豊田中央研究所)</p>	<p>[2B4] JEITA・実装技術ロードマップ 2015 報告会 -2</p> <p>1. IoTを支えるプリント配線板</p> <p>2. 世界の実装現場を支える日本の実装設備</p> <p>3. 実用化が期待される三次元実装技術</p>	<p>[2C4] 高速・無線伝送</p> <p>1. 高速信号の伝送特性を改善させる信号配線層分離型実装構造の開発 ○赤星知幸, 福盛大雅, 水谷大輔, 谷 元昭(富士通研究所)</p> <p>2. 狭間隔部品実装技術によるキャパシタ内蔵インターポザの電源インピーダンス評価 ○菊地克弥¹, 氏家昌章², 高山慎也²(¹産業技術総合研究所, ²アリナ)</p> <p>3. 腕部に装着されたコイルの磁界結合を利用する人体周辺通信—腕部折り曲げに対する伝送特性— ○藤田佑輔¹, 越地福朗¹, 越地耕二²(¹東京工芸大学, ²東京理科大学)</p> <p>4. 広帯域アンテナにおける放射素子の非対称化による広帯域化 ○善方翔太¹, 越地福朗¹, 越地耕二²(¹東京工芸大学, ²東京理科大学)</p> <p>5. 外科手術におけるエネルギー機器への無線電力伝送の研究 ○鶴田尚英, 松井 亮(オリンパス)</p>	<p>[2D4] 3次元ICパッケージ-3</p> <p>1. シリコン基板雑音監視によるTSVバス不良検出回路 ○荒賀佑樹, 菊地克弥, 青柳昌弘(産業技術総合研究所)</p> <p>2. 3次元積層LSIにおけるTSVを経由する線路の信号伝送特性 ○佐々木真, 只木進二, 赤松俊也, 石塚 剛, 作山誠樹(富士通)</p> <p>3. 65nm MOSFETやCMOSインバータの電気特性に及ぼすTSVの応力の影響 ○田代浩子, 石塚 剛, 北田秀樹, 作山誠樹(富士通研究所)</p> <p>4. 動作発熱によって生成される三次元集積回路内の局所応力に関する研究 ○木野久志, 橋口日出登, 谷川星野, 菅原陽平, 池ヶ谷俊介, 福島晋史, 小柳光正, 田中 徹(東北大学)</p>
16:50				